

苏州晶方半导体科技股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介

股票简称	晶方科技	股票代码	603005
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段佳娟	胡萍	
电话	0512-67730001	0512-67730001	
传真	0512-67730808	0512-67730808	
电子信箱	info@wslcp.com	info@wslcp.com	

二、主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民币					
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)		
总资产	1,760,969,126.84	1,061,318,853.90	65.92		
归属于上市公司股东的净资产	1,470,439,661.57	750,777,560.89	95.86		
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)			
经营活动产生的现金流量净额	59,597,905.65	85,073,528.65	12.37		
营业收入	271,575,637.21	198,532,298.09	36.79		
归属于上市公司股东的净利润???	86,303,878.94	72,433,580.11	19.15		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	79,359,685.91	71,622,609.43	10.80		
加权平均净资产收益率(%)	6.45	10.45	减少4个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.39	0.38	2.63		
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	2.63		

单位:股					
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)		
截止报告期末股东总数			16,308		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD	境外法人	25.21	57,160,964	57,160,964	无
中新苏州工业园区创业投资有限公司	境内法人	24.28	55,048,276	55,048,276	无
OMNIVISION HOLDING (HONG KONG) COMPANY LIMITED	境外法人	13.35	30,261,687	30,261,687	无
美莱尼通-中研药业投资有限公司	其他	5.98	13,440,638	13,440,638	无
苏州工业园区翠亭企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.69	3,826,731	3,826,731	无
GILLAD GAL-OR	境外自然人	1.56	3,530,530	3,530,530	无
苏州豪正企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.43	3,238,688	3,238,688	无
金国社律基金——七组合	境内非国有法人	1.08	2,441,229	0	未知
苏州弘盛投资有限公司	境内非国有法人	0.72	1,632,113	1,632,113	无
中国工商银行-壹安价值增长股票型证券投资基金	未知	0.53	1,200,000	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2014年上半年,全球半导体景气持续增强,我国集成电路产业继续保持增长态势,在此背景下,公司积极推进项目建设,有效提升封装产能;不断加大对技术的持续研发投入,推进12寸WLCSP封装技术的量产工作;不断拓展终端应用领域,随着市场新增亮点与新产品合作模式,公司经营业绩保持了平稳增长。报告期内,公司实现营业收入271,575,637.21元,同比增长69.79%;净利润86,303,878.94元,同比增长19.15%。

3.1主要业务分析

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币									
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)						
营业收入	271,575,637.21	198,532,298.09	36.79						
营业成本	125,707,915.72	88,038,857.76	42.79						
销售费用	595,685.64	722,283.41	-17.53						
管理费用	-55,001,194.89	24,252,352.39	126.79						
财务费用	-4,949,477.73	1,686,880.70	-372.66						
经营活动产生的现金流量净额	59,597,905.65	85,073,528.65	12.37						
投资活动产生的现金流量净额	-109,812,483.21	-159,951,632.59	-27.25						
筹资活动产生的现金流量净额	61,927,498.42	44,291,400.00	1,288.37						
研发支出	414,749,842.68	12,233,371.76	241.84						
营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致									
营业成本变动原因说明:销售规模增加所致									
销售费用变动原因说明:员工教育、差旅费降低所致									
管理费用变动原因说明:研发投入增加所致									
财务费用变动原因说明:利息收入增加所致									
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳务收到的现金增加所致									
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产及无形资产支出减少所致									
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:首次公开发行股票募集资金到位所致									
研发投入变动原因说明:技术开发与创新产生的研发投入增加所致									
3.2行业、产品或地区经营情况分析									
3.2.1主营业务分行业、分产品情况									

单位:元 币种:人民币									
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年增减	上年增减	比上年增减	比上年增减	比上年增减	比上年增减
分行业									
电子元件	271,368,032.93	125,694,165.97	53.68	36.76	42.81	减少1.96个百分点			
主营业务分产品情况									
分产品									
芯片封装	269,092,967.15	125,525,442.58	53.35	37.04	42.86	减少1.90个百分点			
设计收入	2,275,965.78	168,723.39	92.59	13.04	11.10	减少0.05个百分点			

单位:元 币种:人民币									
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年增减	上年增减	比上年增减	比上年增减	比上年增减	比上年增减
地区									
外销	245,528,880.98			34.70					
内销	25,840,051.95		60.01						

3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币									
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年增减	上年增减	比上年增减	比上年增减	比上年增减	比上年增减
地区									
外销	245,528,880.98			34.70					
内销	25,840,051.95		60.01						

3.3核心竞争力分析
3.3.1核心竞争力分析详见公司2013年年度报告第四节“董事会报告”相关内容。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

3.4投资状况分析
3.4.1对外股权投资情况分析
2013年6月31日,经公司第一届董事会第九次会议审议通过,公司拟对外投资2,000万元认购华进半导体封装技术研究中心(有限合伙)新增的人民币2,000万元注册资本。并在完成增资后将持有该公司3.89%的股权。公司于2014年4月完成出资,相关工商变更登记手续已办理完毕。公司持有该公司12.42%的股权。华进半导体封装技术研究中心(有限合伙)主营业务为集成电路封装系统设备等相关技术研发;半导体电路和系统设备的技术研发。技术服务及系统集成;利用自有资产对外投资;培训服务(不含教育、不含国家规定的认可的职业技能类培训);自研各类产品及技术的进出口业务。

3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(一)委托理财的情况
1.委托理财的基本情况

单位:元 币种:人民币									
单位名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期收益方式	预计收益	是否逾期未收回	是否涉诉	资金是否并账
中国银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	50,000,000	2014年4月25日	2014年10月25日	预期收益=理财资金*预期收益率*投资期限+本金*预期年化收益率	1,485,476.16	是	否	自有资金
交通银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	30,000,000	2014年4月25日		预期收益=理财资金*预期收益率*投资期限+本金*预期年化收益率		是	否	自有资金
中信银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	30,000,000	2014年4月25日		预期收益=理财资金*预期收益率*投资期限+本金*预期年化收益率		是	否	自有资金

公司第一届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品议案》,具体内容为:公司拟使用自有资金购买银行理财产品(以下简称“理财产品”),截至2014年6月30日,公司已购买了3次银行理财产品,均为保本浮动收益型,其中在中信银行股份有限公司苏州分行购买的两次理财产品为智能活期理财产品,该产品以投资者的每笔买入单位累计存续天数、当段投资期限大于等于90天对应的客户预期收益率为5.1%,公司预计持有该两款理财产品的期限为3—12个月。

(二)委托理财事项
1.3.4.3募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金已累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	是否产生收益	是否达到计划进度	变更原因及募集资金变更项目说明
							预计收益情况	预计收益	收益和收益说明	
先进封装数 芯片尺寸封 装（WLSCP） 投改项目	否	66,735.81	57,567.60	57,567.60	否	完成项目 投资总额 的66.45%				
<p>公司募投项目立项于2010年，分别于2010年12月和2011年1月取得江苏省环保厅、江苏省经信委的批复，取得相关批复后公司用自有资金对项目进行了预先投入，截至2014年2月28日，预先投入金额为49,761.87万元。</p> <p>2014年2月，公司完成首次公开发行股票的上市挂牌工作，并为募投项目募集66,735.81万元的募集资金，2014年4月，公司将预先投入的自筹资金以募集资金进行了置换，由于募集资金到位时间延迟，公司募投项目的建设说明有所延长，公司正积极推进项目的建设工作，力争2014年完成项目的投资与建设，并根</p>										